

平安证券股份有限公司
关于上海伟测半导体科技股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为承接上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责伟测科技的持续督导工作，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	伟测科技已与平安证券签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，伟测科技未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，伟测科技在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构在本持续督导期间，与伟测科技保持密切的日常沟通，通过定期或不定期回访、现场检查等方式持续关注伟测科技生产经营、信息披露情况，对伟测科技开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构在本持续督导期间，督导伟测科技及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，

序号	工作内容	实施情况
		切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等。	保荐机构在本持续督导期间,督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对伟测科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查,伟测科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构在本持续督导期间,督促伟测科技严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构在本持续督导期间,对伟测科技的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	本持续督导期间,伟测科技及其控股股东、高级管理人员因信息披露违规,存在被上海证券交易所出具监管关注函的情况,该监管警示所列事项系上交所的自律监管措施,不属于重大违法违规,公司已对相关事项进行整改并将整改报告提交上交所。保荐机构已督促公司完善内部控制制度,强化相关人员对法律法规及规范性文件的理解,提升专业识别与判断能力,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整地做好信息披露工作。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间,伟测科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清。	本持续督导期间,经保荐机构核查,伟测科技未出现该等事项。

序号	工作内容	实施情况
	上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间,伟测科技及其控股股东因违反上市规则,存在被上海证券交易所出具监管关注函的情况。该监管警示所列事项系上交所的自律监管措施,不属于重大违法违规,公司已对相关事项进行整改并将整改报告提交上交所。 公司已在上市公司公开披露的(2026-033)号公告《上海伟测半导体科技股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》 “二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况”中对该监管措施和对应整改情况进行了充分披露。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐人已制定了对伟测科技的现场检查工作计划,并明确了现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。本持续督导期间,伟测科技不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

本持续督导期间,除前述“一、持续督导工作情况”第14条所列情况外,保荐机构和保荐代表人未发现伟测科技存在其他需要整改的重大问题。

三、重点风险事项

本持续督导期间,公司主要的风险因素事项如下:

（一）核心竞争力风险

1、技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

2、研发与技术人才短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（二）经营及财务风险

1、公司新建产能消化风险

公司在上海、成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。无锡项目和南京项目均已投入使用。公司新一期可转债募投项目按照整体建设规划稳步推进。项目投入使用后，公司产能规模，尤其是高端测试产能规模得到进一步提升。虽然公司投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对投资项目的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司研发、技术迭代或市场需求不及预期、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未

能采取有效措施应对，则公司新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

2、进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平跻身国内先进行列。与此同时，公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和核心技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施의 局限性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

4、主营业务毛利率波动的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

5、扩大产能新增较大费用支出的风险

公司自 2023 年采取扩大测试产能的策略至今，公司经营规模不断扩大，伴随着设备采购、厂房建设、人员扩招等大额支出也不断增加，对公司业绩有直接

影响。如果新增产能项目产能利用率不及预期，市场需求或大客户订单未达预期，新增产能将长期处于低负荷运转，固定成本难以有效摊薄，无法实现预期效益，则扩大产能新增的固定成本结构刚性上升，折旧、人员工资等费用将会对公司未来经营业绩造成不利影响。

6、客户集中度较高的风险

2023 年至 2026 年 1-6 月各期，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为 39.51%、41.87%、39.59%及 34.39%，报告期内客户集中度较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

7、应收账款回收风险

随着公司营业收入规模不断扩大，公司应收款项也相应增加。报告期末应收账款账面价值为 57,955.91 万元，占期末流动资产的比例为 30.61%，占当期营业收入的比例为 54.07%。报告期内，公司主要对应收账款计提了坏账准备，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险；如客户财务状况出现恶化、信用风险集中发生，将会对公司财务状况及未来业绩造成不利影响。

（三）行业风险

随着人工智能、5G 通信、高性能计算和汽车电子等领域的爆发式增长，集成电路测试作为保障芯片性能与可靠性的关键环节，其市场需求呈现出持续、强劲的扩张态势。面对这一趋势，各类测试服务商加大资金投入，积极扩充产能，以期抢占更大的市场份额。其中，封测一体化企业凭借其在封装与测试环节的天然协同优势和规模效应，持续优化生产线并引入高端测试设备；而独立第三方测试头部企业则依托其专业聚焦、服务灵活性和广泛的客户覆盖，也在加速产能建设和新技术研发。这种全行业的积极扩张态势，直接导致了集成电路测试服务市场的竞争格局变得非常激烈，已从单纯的价格竞争，逐步演变为涵盖技术先进性、成本控制力、服务质量、响应速度和综合解决方案能力的全方位角逐。若公司未

来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

（四）宏观环境风险

近年来，全球主要经济体贸易摩擦持续升温，全球贸易环境恶化，全球经济发展存在极大不确定性，对我国集成电路行业造成一定的冲击。截至目前，公司现有进口设备及投资项目所需进口设备尚未受到进口“卡脖子”管制及使用限制。公司始终严格遵守中国和其他国家的法律，但国际局势瞬息万变，一旦贸易政策、关税、出口限制、其他贸易壁垒进一步恶化，使得我国部分产业发展及半导体行业生态链受到冲击，公司可能面临设备采购限制和下游客户需求下降等风险，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受宏观政策、宏观经济形势等因素影响，并且与下游行业及宏观经济周期密切相关。宏观经济下行的风险或将对公司所处行业造成冲击，短期内造成下游客户需求疲软，或有可能影响公司相关业务的开展。

四、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据如下表所示：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	1,071,859,786.42	634,252,628.82	69.00
利润总额	167,428,742.54	102,673,574.38	63.07
归属于上市公司股东的净利润	159,311,093.39	101,078,388.85	57.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,751,927.16	53,717,284.25	171.33

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	547,488,321.54	339,442,813.28	61.29
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 6 月末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	4,227,916,123.67	2,967,369,720.90	42.48
总资产	9,434,253,377.36	7,726,481,316.61	22.10

（二）主要财务指标

主要财务指标	2026年1-6月	2025年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.01	0.68	48.53
稀释每股收益（元 / 股）	0.93	0.68	36.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.92	0.36	155.56
加权平均净资产收益率（%）	4.41	3.78	增加 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.04	2.01	增加 2.03 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	8.39	12.95	减少 4.56 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的变动说明

2026年上半年公司实现营业收入107,185.98万元，较上年同期增加43,760.72万元，同比增长69.00%；实现归属于上市公司股东的净利润15,931.11万元，较上年同期增加5,823.27万元，同比增长57.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,575.19万元，较上年同期增加9,203.46万元，同比增长171.33%。公司业绩增长正受益于“增量扩容”与“存量替换”的双轮驱动。

报告期内，随着国内AI大模型从“训练”向“推理”应用场景的快速迁移，本土AI芯片企业纷纷推出新产品，比如针对边缘计算、端侧智能的专用推理芯片（ASIC）。这类芯片往往采用多芯片封装（Multi-Chip Module）和异构计算架构，其高带宽、低功耗的特性对测试机的电压精度、时域测量能力提出了严苛要求，直接拉动了公司高端测试的需求。同时，智能驾驶的高渗透推动车规级MCU、SiC功率模块及智能座舱SoC的装车量增加，这类芯片对零缺陷（Zero Defect）的追求使得公司在嵌入式IP测试、三温测试及老化测试等高端服务占比

提升。最后，在 AI 服务器、智能座舱、高端工业等领域，需要存储越来越复杂的系统固件和 AI 模型，使得大容量 NOR Flash 需求快速增长。随着这些大容量、高性能芯片出货量增加，与之配套的测试需求也同步扩张。以上三重动能叠加公司新建产能有序爬坡，规模化效应带来的固定成本摊薄正逐步兑现为利润释放。

此外，随着 Chiplet 技术的商业化普及和 HBM（高带宽内存）的堆叠应用，针对 2.5D/3D 封装芯片的 Burn-in 测试和系统级测试（SLT）需求正呈指数级增长；而消费电子领域对射频前端模组（PAMiD）及 MEMS 传感器的测试规格升级，也给公司带来了存量市场的结构性替代机会。

截止 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产为 422,791.61 万元，较上年末增长 42.48%，主要系本期收入规模增长带动利润增长以及本报告期公司触发有条件赎回条款后，公司行使可转债提前赎回权，大部分债券持有人选择债转股致股本和资本公积增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、人才优势

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂威宇科技测试封装（上海）有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力。公司亦高度重视研发人才的培养与引进。截至期末，公司研发与技术人员占比约 20%，主要研发人员平均从业年限在 6 年以上，强大的研发团队保障了公司在技术方面的领先地位。公司不断健全公司长效激励机制，制定了多期限限制性股票激励计划以吸引和留住优秀人才。

2、技术优势

公司自创立之初就定位于专业的独立第三方集成电路测试服务商，通过技术研发和工艺升级提高测试服务的品质是公司始终的诉求。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。在测试方案开发方面，公司突破了 5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能算力芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化。在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

3、客户优势

公司作为独立第三方测试企业没有封装业务，只有测试业务，因此能够从中立客观的角度公正地向客户呈现测试的客观结果，在此方面更易获得客户的认可。公司持续加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，成为大陆各芯片设计公司高端芯片测试的自主可控的重要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。

公司的客户包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司营业收入中占比较大的客户为集成电路设计公司，公司客户超过 200 家，其中高端芯片设计公司出于对其自身测试服务需求的把控、成本控制以及风险控制，将为其提供测试业务供应商的选择由境外转向境内。

4、产能规模优势

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，除了备受重视的研发投入规模以外，测试产能规模是集成电路测试企业的核心竞争力之一。充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。足够的测试产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行

业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。此外，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，故高端测试产能相对紧缺；而进行高端测试需使用高端测试设备，这些设备采购价格较高，交付周期相对较长，且相关设备的研发及生产长期被海外巨头垄断，每年供给的数量相对有限。

与同行业公司相比，公司十分重视产能规模尤其是高端测试产能的建设。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求、集成电路行业新产品和终端应用对产品的需求和要求，以及对行业整体发展的认知，2025 年公司积极实施扩产计划，继续购入爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试相关设备。截至目前，公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

5、区位优势

公司拥有上海、南京、无锡和深圳四个测试基地。公司以长三角市场和珠三角市场为双引擎，连接全球半导体产业链（设计、制造、设备），覆盖中高端制造集群，贴近终端客户，有利于快速响应客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求、有利于降低芯片运输损耗与时间成本，有利于灵活调配产能与缩短供应链周期。同时，长三角和珠三角人才储备充足、高校资源丰富，公司在人才招聘上有着巨大优势。最后，长三角和珠三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。为进一步扩大市场占有率，公司将通过成都项目完善全国战略布局，填补西南区域空白，以此形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和西南地区的全国性服务网络。

（二）核心竞争力的变化情况

2026 年上半年，伟测科技的持续竞争力未发生重大不利变化。

七、研发投入及变化情况

（一）研发投入情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	89,982,092.08	82,133,746.35	9.56
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	89,982,092.08	82,133,746.35	9.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.39	12.95	减少 4.56 个百分点

（二）研发进展

1、报告期内研发成果

2026 年上半年，公司研发工作有序推进，公司新获得发明专利 9 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 31 项、外观设计专利 1 项。截至 2026 年 6 月末，公司累计获发明专利 28 项、实用新型专利 83 项、软件著作权 163 项、外观设计专利 1 项。

2、在研项目情况

2026 年上半年，公司在研项目情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	基于硅通孔（TSV）工艺高性能 AI 产品整体测试方案	研发阶段	设计并制定高覆盖、高稳定性、高可靠测试方案和流程；积累高达上千高速接口测试方法；大存储器测试和修复的标准测试方案和代码库；设计全新超高功率芯片热管理方案；设计兼容芯片 DFT-Scan 和 Mbist 并行测试方案；制定该类产品量产导入的验证和数据标准。
2	测试研发自动化系统(一期)	研发阶段	针对当前测试研发中涉及项目技术/管理脱节的问题开发一个专业的测试开发平台，将集成电路测试研发的技术/管理问题在同一平台进行推进。该平台在技术上会使用 AI 大模型对项目研发和调试涉及的代码/调试技能进行自动化的开发和调试经验的总结，也会拥有自动化的品质验收规划如测试数据分析，程序分析，代码分析进行自动审核，项目管理上会自动生成项目管理流程及节点，项目异常报警等。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
3	3D 堆叠封装芯片成品软硬件测试方案开发	研发阶段	3D 堆叠封装芯片将多颗裸片垂直叠放，依靠 TSV 硅通孔、微凸点、Cu-Cu 混合键合实现层与层之间垂直互连，其 DFT 部分数据量大，涉及多个 IP 功能验证、Die-to-Die 合封互联通路验证等，该项目涉及 SSN 部分，测试项较复杂，此测试方案极大提高了对于 SSN 的实战经验，有力提高 3D 堆叠芯片 ATE 测试开发的竞争力。
4	半导体测试全场景 AI 图像识别系统开发	研发阶段	整合晶圆 Mapping、芯片外观、载具三大检测场景，搭建统一 AI 视觉识别平台；降低人工干预率，提升单线日均产能，节约人工成本；提高晶圆缺陷识别率，提升载具检测速度。引入迁移学习算法，减少模型训练周期；开发通用多设备兼容接口，适配 PMI、CDC 等 5 类检测设备；平台 7×24 小时连续运行稳定性提升。
5	3D 高性能人工智能芯片测试方案	研发阶段	解决 3D 堆叠后 wafer 存在较大的翘曲对晶圆测试构成的技术挑战；RAM 测试在堆叠前后测试测试方案及方案选择；超大 package 对成品和热传导的挑战；芯片功耗极高超千 W 且发热功率密度也超 150W/cm ² ；芯片集成多种高速接口如 Serdes/PCIE/UCIE/DDR/USB/ETH/MIPI/DP 等整体高速接口数量超千条。对探针台进行技术升级使其能够满足对高翘曲的 wafer 进行测试，当前已经可以满足翘曲达到 4mm 的 wafer 的测试能力远超当前 3Dwafer 翘曲；对 RAM 堆叠前测试软硬件方案进行相关开发设计形成测试 IP；RAM 堆叠后高并行测试方案的研发和推进；AI 芯片综合热管理方案和规范的形成；多种高速接口软硬件方案的固化；多流程综合分 Bin 方案的研发以及 OLB 方案研发；跨流程数据分析和综合分析。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
6	基于 GPIB 协议的 Handler/Prober 测试设备统一控制系统研发	研发阶段	利用基于 GPIB 通用通信协议自主研发协议转换中间模块，适配爱德万、泰瑞达等全品牌设备；支持多台设备同时在线管控；总线数据智能分析实现故障预警与精准定位。实现多品牌设备协议标准化、集中管控、智能故障诊断、MES 互通；
7	半导体测试设备异常行为预警系统	研发阶段	覆盖厂区 J750、OPUS 测试设备 7×24 小时自动化监测，替代人工巡检，融合行为识别、时序动作定位、时空行为检测三大 AI 技术构建智能分析引擎；形成自主知识产权软件系统；规范人员操作、强化设备全生命周期管理；打造行业标杆产品，增强企业竞争力，拓展对外技术服务业务。
8	基于 2.5D 封装工艺高性能光计算芯片晶圆测试方案	研发阶段	设计并制定高稳定性光源控制方案、光路衰减及校准方案、光源对准及校准机构、高稳定性光耦合方案；设计全新的 224G 高速接口测试电路和电气连接方案、设计超高速电信号测试分析方案；制定该类产品量产导入验证流程尤其是校准流程和数据验收标准。
9	基于 Camtek ADC 的半导体测试图像精度优化与智能分析系统	研发阶段	解决现有 Camtek-ADC 精度不足、效率低、人工依赖高、数据追溯难问题，适配大批量多品类量产。
10	系统级测试自动化控制系统	已结项	解决量产数据和品质无法有效管控等系列问题。本次开发是通过开发系统级测试通用平台以达到系统级测试标准化自动化的目标，形成公司在系统级测试 IP。
11	高性能 ADAS 芯片测试方案	已结项	针对车规高性能 ADAS 芯片测试方案进行系统级测试，形成车规级高性能 ADAS 芯片产品形成标准的测试软硬件方案和代码库；并对车规高性能 ADAS 芯片电气性能、硬件功能、软件功能和性能以及车规级使用的极端温度环境下产品稳定性的分析建立完整的流程和方法；并对未来“舱驾一体”高性能 ADAS 芯片测试方案进行技术预研。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
12	半导体测试车间 ESD 监控系统升级	研发阶段	统一五地 ESD 管理标准，消除监控盲区，实现全域监控、智能防护、跨基地协同管理。
13	2.5D 封装超高并行度高性能服务器高速数据交换芯片测试方案	研发阶段	设计覆盖低速和高速测试且高达 512 对 112G/224G 高速接口的软硬件方案；提出综合性热管理方案，该方案包含硬件的全套散热方案以及对应的热仿真/应力仿真/形变仿真...等并制定相应的标准，与此同时电路设计层面也更接近芯片的分流和电路保护方案，软件层面制定体系化的开发流程和优化规范，并在分区浮动头、新型 socket、相变传热等进行相关的研究和开发
14	基于 chroma 平台的车规低成本测试方案的研发（一期）	研发阶段	利用 Chroma 平台在车规集成电路低成本测试方案的研发，研发全新的测试方案、测试流程，以及对应的技术手段降低车规集成电路对测试平台的要求，以实现测试覆盖率和测试成本之间取得最优的平衡。以满足未来车规集成电路对于测试的多样化要求。
15	高性能 AI 芯片国产老化测试方案	研发阶段	定制化研发超高功耗 AI 芯片的老化测试方案。具体覆盖：长期高温环境下，超高功耗超 1000A，高稳定，低纹波的电源供电方案；新型高稳定性传热方案如：水冷/相变/ATC 等；芯片和环境异常追踪以及异常处理措施；分区热管理方案；老化下热/力/电仿真方案级规范；形成公司在应对以超高功率 AI 芯片为代表的国产老化测试方案，并对该方案形成若干子 IP 化，以方便后续在其他产品上实现全部/部分快速移植。
16	AI 算力芯片成品测试方案	研发阶段	AI 算力芯片一般为多 DIE 合封工艺，其 DFT 部分数据量大，涉及多个 IP 功能验证、Die-to-Die 合封互联通路验证等，测试项复杂，测试周期长，同时需要按照测试结果完成出货等级的筛选；开发此测试方案，旨在提升公司在 AI 算力芯片 ATE 测试中的竞争力。

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标
17	探针过驱量确定方法及半导体设备的改造	研发阶段	技术层面：自主攻克自适应过驱计算、双闭环控制、设备模块化集成、晶圆损伤保护四大核心技术，补齐公司高精度探针控制技术短板。 生产层面：解决晶圆边缘芯片压伤、测试一致性差、探针损耗快等痛点，提升测试良率、降低芯片报废、延长探针使用寿命。 落地层面：打造标准化、可跨机型复制的探针台改造方案，输出完整 SOP 与技术规范，满足先进制程、12 英寸晶圆、Chiplet、车规芯片量产测试需求。
18	Wifi 7 无线基带芯片测试方案	已结项	实现 Wifi7 无线基带芯片测试方案的研发，为后续产品量产提供相应的测试方案和技术积累；持续完善在射频领域的测试方案；紧跟最新射频通讯技术的发展和测试技术的挑战并制定方案；为未来 6G 和下一代 Wifi8 射频通信测试技术进行相应的预研

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，募集专户均已注销，节余募集资金 8.17 万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。本报告期内，不存在募集资金使用情况。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股均不存在质押、冻结及减持的情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


吉丽娜


牟军

